

PCN#20141119000A
TSSOP パッケージ一部製品組立/検査サイト追加認定

お客様各位

Revision A は、Group 1 記載の対象製品について、追加組立サイトとして ASESH 社サイトの追加によって生じる組立部材(BOM)相違点を update するためのものです。

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただけましたものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知初版発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知初版発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

尚、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

PAGE 2:

Attachment: 1

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。変更内容詳細は下記を参照ください。

PCN 番号:	20141119000A	PCN 日付:	01/20/2015																
表題:	TSSOP パッケージ一部製品 ASE Shanghai 社組立/検査サイト追加認定																		
PCN 詳細																			
変更内容:																			
<p>Revision A は、Group 1 記載の対象製品について、追加組立サイトとして ASESH 社サイトの追加によって生じる組立部材(BOM)相違点を update するためのものです。ASESH 社サイトは、Matte Sn 端子表面処理(lead finish)にて対象製品を製造します。本通知修正は、下記に強調文字で黄色ハイライト表記されています。</p> <p>TI は、下記 Group 1 記載の対象製品について、追加組立/検査サイトとして ASE Shanghai 社(ASESH) サイト、及び下記 Group 2 記載の対象製品について、追加組立サイトとして TI-Taiwan(TAI)サイトの認定を連絡します。Group 2 製品は、2 サイト間で同一の部材(BOMs)を使用します。Group 1 製品については、部材(BOM)の違いは下表の通りです。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>What</th> <th>MLA</th> <th>AP1</th> <th>ASESH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mold Compound</td> <td>4206193</td> <td>SID# 101325962</td> <td>SID#EN2000508</td> </tr> <tr> <td>Mound Compound</td> <td>4042500</td> <td>SID#101306338</td> <td>SID#EY1000063</td> </tr> <tr> <td>Lead Finish</td> <td>NiPdAu</td> <td>NiPdAu</td> <td>Matte Sn</td> </tr> </tbody> </table> <p>Test coverage 内容、条件は、現行テストと一致しており、テスト生産性認定試験(Test MQ)にて検証されます。</p> <p>本 PCN 変更実施以降、TI は、対象製品の鉛フリー対応製品を、単一の標準製品名 (single standard part number)に統合します。例えば、AM26C31PWRの製品名で Matte Sn もしくは NiPdAu/Ag 表面処理の製品が出荷されることとなります。</p> <p>例:</p> <ul style="list-style-type: none"> —お客様が AM26C31PWR 製品 7500 個(標準梱包数量(SPO): 2500 個/リール)を発注します。 —TI は、上記発注に対して下記の何れかの出荷形態で対応します。 <ul style="list-style-type: none"> I. NiPdAu 端子表面処理製品 3 リール II. Matte Sn 端子表面処理製品 3 リール III. Matte Sn 端子表面処理製品 2 リール+NiPdAu 端子表面処理製品 1 リール IV. NiPdAu 端子表面処理製品 2 リール+Matte Sn 端子表面処理製品 1 リール 				What	MLA	AP1	ASESH	Mold Compound	4206193	SID# 101325962	SID#EN2000508	Mound Compound	4042500	SID#101306338	SID#EY1000063	Lead Finish	NiPdAu	NiPdAu	Matte Sn
What	MLA	AP1	ASESH																
Mold Compound	4206193	SID# 101325962	SID#EN2000508																
Mound Compound	4042500	SID#101306338	SID#EY1000063																
Lead Finish	NiPdAu	NiPdAu	Matte Sn																
変更理由:																			
供給確保																			
外観, 寸法, 機能, 品質, 信頼性(positive/negative)に関する懸念事項:																			
なし																			

注記)

1. 本資料は英語原文(一部)の日本語訳になりますが、TIの公式文書はあくまで英語原文になります。英語原文と日本語訳に齟齬がある場合には、英語原文が優先されます。
2. 上記項目以外、本資料に日本語訳が記載されていない項目については英語原文を参照ください。

原文のみ記載の項目例：

- **Proposed 1st Ship Date** (変更品出荷開始予定日)
- **Last date to order/Last date to ship** (最終受注日/最終出荷日)
- **Estimated Sample Availability** (サンプル入手可能予定時期)
- **Change Type** (変更項目タイプ)
- **Changes to product identification resulting from this PCN** (本変更による製品識別の変更)
- **Product Affected** (対象製品)
- **Qualification Data** (認定試験データ)
- **Appendix** (付属資料) 等